

RJ45C5 R1U 2.2N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

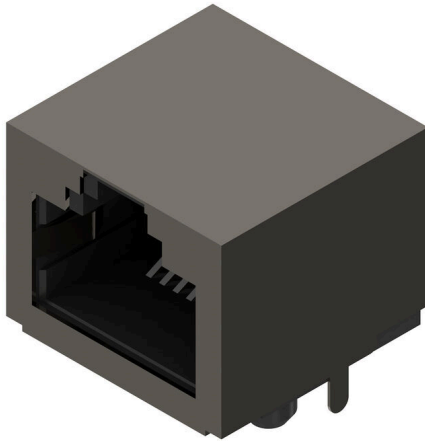
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



本製品のラインナップは、下記設計を網羅しています：

- 90°アングル（水平）および180°ストレート（垂直）
- ラッチアップ/ラッチダウン
- THT、THR、SMDはんだプロセス
- 幅広いデザインタイプ、LED内蔵、シールドタブ付き
- パフォーマンスカテゴリ3 から Cat. Cat.6。
- トレイ包装（TY）またはテープ・オン・リール（RL）
- ANSI / TIA-1096-AおよびIEC 60603に準拠したモジュラーRJ45コネクタに対応
- 絶縁耐力 ≥ 1500 V AC RMS（2250 V ACピーク値）、IEEE 802.3準拠
- IEC 60603に準拠した絶縁耐力 ≥ 1500 V AC（ピーク値）または ≥ 1500 V DC

特性と長所：

- 最大性能に対応する - 40°C から + 85°C の温度範囲拡張
- 30µ" 金メッキで耐腐食性を強化
- 0.3mm 以上のスタンドオフによる最適なはんだ付け加工

一般注文データ

バージョン	データの最小化 - RJ45モジュージャック、プリント基板用プラグインコネクタ, Cat. 5, THT/THR はんだ接続, 90°, 上部, なし, いいえ, プラギング回数: 750, 極数: 8, PA 9T, 30...80 µ" / ≥ 30 µ", Tape
注文番号	3066290000
種別	RJ45C5 R1U 2.2N4N RL
GTIN (EAN)	4099987063128
数量	240 items
パッケージ	Tape

RJ45C5 R1U 2.2N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	15.7 mm	奥行き (インチ)	0.6181 inch
高さ	13.11 mm	高さ (インチ)	0.5161 inch
幅	16.4 mm	幅 (インチ)	0.6457 inch
正味重量	8.19 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

極数	8	LED	いいえ
ソルダーピン長 (l)	2.2 mm	PCB の取り付け	THT/THRはんだ接続
ピッチ (インチ) (P)	0.050 "	シールド材質	真鍮
シールド	はい	側面終端、特性	はんだフランジ
ソルダーアイレット穴直径公差 (D)	±0.1 mm	極当たりソルダーピン数	1
接続方式	はんだ接続	カテゴリー	Cat. 5
製品ファミリー	データの最小化 - RJ45モジュラージャック	ピッチ (mm) (P)	1.02 mm
保護度合い	IP20	ブラギング回数	750
外向きエルボ	90°	シールド面	ニッケルメッキ
シールドタブ	なし	性能カテゴリ	Cat. 5
はんだ付け工程	リフローハンダ付け, 手動はんだ付け, フローはんだ付け	ラッチオプション	上部
はんだピン寸法	八角形		

標準

コネクタ規格 IEC 60603-7

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	1500 V DC	耐電圧、接点 / 接点	1000 V DC
体積抵抗	<25 mΩ	絶縁抵抗	≥ 500 MΩ
公称電圧	125 V	PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合

材料データ

絶縁材	PA 9T	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	II
比較追跡指数 (CTI)	≥ 500	絶縁抵抗	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 可燃性等級	V-0
接点ベース素材	リン青銅合金	接点材質	銅合金
接触表面	ニッケル下地金メッキ	はんだ接続の層構造	30...80 μ"
プラグ接点の層構造	30...80 μ" / ≥ 30 μ"	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	85 °C	動作温度、最小	-40 °C
動作温度、最大	85 °C		

RJ45C5 R1U 2.2N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

梱包

パッケージ	Tape	VPE 長	354.00 mm
VPE幅	345.00 mm	VPEの高さ	129.00 mm

重要なメモ

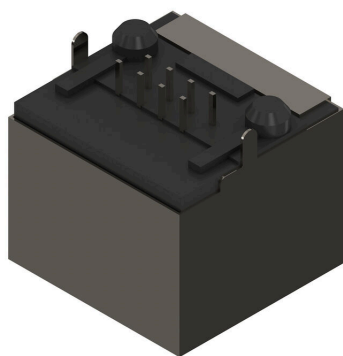
注意事項

分類

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

図面

製品イメージ



RJ45	G1	R	1	U	3.2	E	4	GY/GY	TY	RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY																											
										<table><tr><td>Packaging</td><td>TY RL</td><td>Tray in box (manual assembly) Tape on Reel (automated assembly)</td></tr><tr><td>LED</td><td>Y/G G/Y GY/GY O/G R/O ... N</td><td>Yellow/Green Green/Yellow (standard) Green-Yellow/Green-Yellow Orange/Green Red/Orange ... (further combinations possible) without LED</td></tr><tr><td>Contact surface thickness</td><td>4</td><td>1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"</td></tr><tr><td>EMI tabs (ground fingers)</td><td>E N</td><td>E = with EMI tabs N = without EMI tabs</td></tr><tr><td>Solder Pin length</td><td>3.2 1.6 D</td><td>3.2 mm 1.6 mm SMD</td></tr><tr><td>Direction, latch style</td><td>U D V Y</td><td>Horizontal (90°, side entry), latch up Horizontal (90°, side entry), latch down Vertical (180°, top entry) Diagonal (45°), latch up</td></tr><tr><td>Number of Ports</td><td>1 12; 14; ... 21; 41; ...</td><td>1 Port multi ports side by side, Multiport multi ports about each other, Multilevel</td></tr><tr><td>Assembly on PCB</td><td>R S T</td><td>Through Hole Reflow - THR Soldering process: Wave or Reflow soldering Surface Mount Technology - SMT Soldering process: Reflow soldering Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave</td></tr><tr><td>Performance Category</td><td>C5 C6 C6A C5e M G1 G10 U MP MP+</td><td>Category 5 Category 6 Category 6A Category 5e 10/100 Mbit 10/100/1000 Mbit 10 Gbit Unshielded 10/100 Mbit with POE 10/100 Mbit with POE+</td></tr></table>	Packaging	TY RL	Tray in box (manual assembly) Tape on Reel (automated assembly)	LED	Y/G G/Y GY/GY O/G R/O ... N	Yellow/Green Green/Yellow (standard) Green-Yellow/Green-Yellow Orange/Green Red/Orange ... (further combinations possible) without LED	Contact surface thickness	4	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"	EMI tabs (ground fingers)	E N	E = with EMI tabs N = without EMI tabs	Solder Pin length	3.2 1.6 D	3.2 mm 1.6 mm SMD	Direction, latch style	U D V Y	Horizontal (90°, side entry), latch up Horizontal (90°, side entry), latch down Vertical (180°, top entry) Diagonal (45°), latch up	Number of Ports	1 12; 14; ... 21; 41; ...	1 Port multi ports side by side, Multiport multi ports about each other, Multilevel	Assembly on PCB	R S T	Through Hole Reflow - THR Soldering process: Wave or Reflow soldering Surface Mount Technology - SMT Soldering process: Reflow soldering Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave	Performance Category	C5 C6 C6A C5e M G1 G10 U MP MP+	Category 5 Category 6 Category 6A Category 5e 10/100 Mbit 10/100/1000 Mbit 10 Gbit Unshielded 10/100 Mbit with POE 10/100 Mbit with POE+
Packaging	TY RL	Tray in box (manual assembly) Tape on Reel (automated assembly)																																			
LED	Y/G G/Y GY/GY O/G R/O ... N	Yellow/Green Green/Yellow (standard) Green-Yellow/Green-Yellow Orange/Green Red/Orange ... (further combinations possible) without LED																																			
Contact surface thickness	4	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"																																			
EMI tabs (ground fingers)	E N	E = with EMI tabs N = without EMI tabs																																			
Solder Pin length	3.2 1.6 D	3.2 mm 1.6 mm SMD																																			
Direction, latch style	U D V Y	Horizontal (90°, side entry), latch up Horizontal (90°, side entry), latch down Vertical (180°, top entry) Diagonal (45°), latch up																																			
Number of Ports	1 12; 14; ... 21; 41; ...	1 Port multi ports side by side, Multiport multi ports about each other, Multilevel																																			
Assembly on PCB	R S T	Through Hole Reflow - THR Soldering process: Wave or Reflow soldering Surface Mount Technology - SMT Soldering process: Reflow soldering Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave																																			
Performance Category	C5 C6 C6A C5e M G1 G10 U MP MP+	Category 5 Category 6 Category 6A Category 5e 10/100 Mbit 10/100/1000 Mbit 10 Gbit Unshielded 10/100 Mbit with POE 10/100 Mbit with POE+																																			

凡例